

Invenția se referă la electronică, în particular la tehnologia de confecționare a materialelor utilizate în electronică și construcția de aparate, și anume la nanostructurile compozite sistematizate.

Procedeul de confecționare a nanostructurii filiforme include confecționarea unui semifabricat prin asamblarea unui fascicul de segmente de microconductoare fiecare în izolație de sticlă, amplasarea fasciculului în interiorul unei fiole de sticlă, vacuumarea și ermetizarea ei și strângerea fasciculului la încălzire până la temperatura de înmuiere a pereților fiolei, subțierea semifabricatului prin întinderea lui până la obținerea nanostructurii filiforme cu nanoconductoare la o temperatură mai înaltă decât temperatura de înmuiere a tuturor componentelor de sticlă și de topire a microconductoarelor în zona de lucru de formare a nanostructurii filiforme, și răcirea ei ulterioară. Subțierea semifabricatului se efectuează prin întinderea consecutivă a acestuia, în mai multe cicluri, totodată întinderea lui în decursul unui ciclu se efectuează sub acțiunea unei forțe constante și a unei temperaturi constante, în așa mod ca raportul acestei forțe față de viscozitatea sticlei în partea inferioară a zonei de lucru de încălzire a semifabricatului să se micșoreze pas cu pas de la ciclu la ciclu proporțional cu micșorarea pătratului diametrului semifabricatului ce se întinde.

Revendicări: 4

Figuri: 4